



【製造技術者/リーダー候補】バックプレーン、サブラック製品等の生産に関する業務◆
ベテラン・シニア層歓迎

設計・製造現場での経験を活かすノマイカー・バイク通勤可

Job Information

Hiring Company

TCS Japan K.K.

Job ID

1607367

Division

製造・製造技術部

Industry

Electronics, Semiconductor

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Kanagawa Prefecture, Fujisawa-shi

Salary

Negotiable, based on experience ~ 8 million yen

Work Hours

9:00～17:30（実働7.5時間、休憩60分）

Holidays

完全週休2日制（土日祝）

Refreshed

August 26th, 2026 00:00

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 3 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Technical/Vocational College

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

≪募集要項・本ポジションの魅力≫

- ・バックプレーン・サブラック製品の生産技術として、工程設計・設備導入・改善・評価まで幅広く担当
- ・試作から量産まで一貫して携わり、生産性向上や品質改善を通じてものづくりに貢献できる
- ・リーダー候補として現場改善や後進育成を担い、海外工場との連携を通じて技術力を高められる
- ・年間休日121日・土日祝休みに加え、研修制度が充実し幅広い技術分野へ挑戦できる

【業務内容】

バックプレーン、サブラック製品等の生産(試作品、量産品)に関する業務全般

<具体的には>

生産準備・設計・評価

- ・新製品の見積検討
- ・生産工程設計
- ・試作品および量産品の製作、試作品の評価
- ・製造図面、組立作業手順書の作成

治工具・設備の開発・導入・メンテ

- ・製造用・検査用治工具類の設計および製作
- ・生産工程の確立・見直し
- ・新規生産設備の検討
- ・治工具・設備のメンテナンス
(油圧プレス、空圧プレス、リフロー炉、はんだ槽、エアコンプレッサ、PSA、電気検査機、他)

現場改善・指導

- ・作業員への作業指導
- ・製品製造工程の効率化・改善の立案および実行
- ・品質トラブル発生時の原因究明および報告書作成

社内外・海外連携

- ・協力会社とのやり取り
- ・グループ会社の海外工場とのやり取り

【雇用形態】

正社員

※試用期間あり、6ヶ月（試用期間中の条件変更なし）

【給与】

年収：～700万円（上限 800 万円）

※経験・能力を考慮の上決定

■残業手当：全額支給（内みなし残業30時間分は月給に含まれる）

■昇給：年 1 回

■賞与：年 2 回（夏季・冬季）

【就業時間】

9:00～17:30（実働7.5時間、休憩60分）

■残業：あり（月30時間程度）

【勤務地】

神奈川県藤沢市遠藤

■アクセス：湘南台駅からバス 15 分

※マイカー通勤・バイク通勤可(無料駐車場あり)

【休日休暇】

- ・年間休日 121 日
- ・完全週休 2 日制(土日祝)
- ・年末年始休暇
- ・有給休暇

【待遇・福利厚生】

- ・社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
- ・通勤手当
- ・車・バイク通勤時のガソリン代支給(社内規定に従う)

Required Skills

※下記の要件スペック全てにおいて、現時点で備わっていなくとも、将来的にご本人が目指したい領域であれば弊社で随時研修を実施します。

【必須要件】

- ・設計・製造現場(生産技術、治工具設計、設備メンテナンス、金属・樹脂加工など)での実務経験 3 年以上
※実務経験 10～20 年以上のベテラン・シニア層の方も大歓迎です。経験年数に応じて給与面も優遇いたします。
- ・工学・技術の基礎知識（電気・電子工学系知識 / 機械工学系知識）

【歓迎要件】

- チームリーダー経験や後輩への指導経験
- 基板設計・生産技術：
 - 基板設計 / 生産関連知識(高速伝送、高多層基板、大型基板、シグナルインテグリティ / パワーインテグリティ)
 - 基板生産設備関連知識
- コネクタ・サブラック関連技術：
 - コネクタ設計 / 生産関連知識(プレスフィット、ディップ、SMT、高速伝送)
 - コネクタ生産設備関連知識(金型、プレス機、成型機、組立機、メッキ)
 - サラック設計 / 生産関連知識、およびその生産設備関連知識
- その他加工・実務経験：
 - ケーブル組立関連知識
 - バスバー関連知識(大電流、高電圧)
 - 部品組立 / 製品組立用治工具類の設計 / 製造経験
 - CAD 設計経験(Auto CAD、Solid Works 等)
 - はんだ作業経験(有資格者優遇)
 - 金属 / 樹脂加工経験
 - 設備メンテナンス経験(油圧機器、空圧機器、プレス機器等)
- PC・語学スキル：
 - PC 操作スキル(Excel、Word、PowerPoint)
 - 英語の読み書き(メールベース)・最低限英語にアレルギーがないこと

【選考について】

- 選考プロセス：書類選考⇒面接 2〜3 回⇒内定

Company Description